

“Tektronix Innovation Forum 2019”



Tektronix Innovation Forum 2019
Bangkok, Thailand
25-June-2019

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้อง Salon A ชั้น 2 , Swissotel Bangkok Ratchada

วิศวกรทุกท่าน มีความอยากรู้อยากเห็น และความมุ่งมั่น ทำให้เราชอบถาม ว่า เพราะอะไร? ถ้าหากแบบนี้ แล้วจะเป็นอย่างไร? เป้าหมายเพื่อหาวิธีการ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้....

วิศวกรเป็นผู้แก้ปัญหา ขยายขีดความสามารถ ทลายกรอบแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม ๆ...ให้ดียิ่งขึ้น!

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทำให้ขอบเขตการตลาดเปลี่ยนแปลงไป มีการรวมกลุ่มพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เร็วขึ้น มีคู่แข่งรายใหม่ ๆ ที่เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด เมื่อความต้องการขยายตัวขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ย่อมถูกกดดันให้ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบันวิศวกรจำเป็นต้องติดค้น ออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่าบทบาทของวิศวกรได้เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต้องการให้คุณไม่เพียงต้องเป็น **นักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม** แต่ยังคงต้องเป็น **ผู้เล่นเกม** อีกด้วย

ยินดีต้อนรับสู่ยุค New Normal

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Tektronix Innovation Forum 2019 ฟรี! ตลอดงาน

**ลงทะเบียนวันนี้!
ลุ้นรับของรางวัล!**

Agenda:

Time	Topic	Speaker
08.30 – 09.00	Registration and Booth Tour	
09.00 – 09.10	Welcome Speech	Mr. Uthai Ubonwanna
09:10 - 09:40	Booths Introduction	Trinergy Staff
09.40 - 10.10	Tektronix Keynote - "Welcome to the New Normal"	Mr. Ronald Dung & Cui Li / Tektronix
10.10 - 10:55	Topic 1: Challenges with Power Rail Analysis and power sequencing.	Mr. Carl Wong / Tektronix
10:55 - 11:25	Tea Break & Booth Tour	
11:25 - 12:10	Topic 2: Reducing Manufacturing Test Time – a Perspective from Electronic Vehicle Battery Test	Mr. Mr. Harry Hu / Tektronix
12:10 - 13:30	Lunch & Booth Tour	
13:30 - 14:15	Topic 3: Next Gen HSS Testing - PCIe 4/5, DDR5, HDMI 2.1	Mr. Chuan Shin Tan / Tektronix
14:15 - 15:00	Topic 4: DataComm (100G/400G NRZ/PAM4 Tx) RT/ET-Scope	Mr. Pavel Zivny / Tektronix
15.00 - 15:30	Tea Break & Booth Tour	
15:30 - 16:15	Topic 5: Versatile Signal Generation for Advance Research, Radar or Electronic Warfare and High Speed Digital Design	Mr. Wei Xiang Tan / Tektronix
16:15 - 16:30	Wrap up & Lucky Draw	

ลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดงานนี้ !!

Topic Description

Topic	Description
<p>Topic 1: Challenges with Power Rail Analysis and power sequencing.</p>	<p>Key learnings: New power supplies and high speed designs require very tight control of their power rails due to tight tolerances on the power rail. These designs require very high power integrity with accurate power management and power sequencing. This session discusses challenges with power integrity measurements and cover following topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power Rail testing requirements (noise and sensitivity) - Efficiency measurements on multiple power rail systems - Power sequencing - Ripple, undershoot, overshoot, PDN and other critical measurements - Proper connectivity tips
<p>Topic 2: Reducing Manufacturing Test Time – a Perspective from Electronic Vehicle Battery Test</p>	<p>Key learnings: Manufacturing test is quite rigorous for any device, however, the production of goods that will be integrated into automobiles tends to be a bit more demanding. We need to ensure the utmost in quality by efficiently testing products, collecting and storing data for analysis, and refining processes to maintain results in less time.</p> <p>When deploying test systems, engineers must be aware not just of the latest test technology, but also the different ways in which their selected equipment can be optimized to ensure the best performance possible. While initial cost will always be a key driver for what an engineer will be permitted to purchase, one can argue that the benefits of more modern instrumentation or enhanced features will reduce overall cost of a system over its lifetime.</p> <p>In this presentation, we will review:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Common production challenges presented to today's engineer • Instrument configuration considerations to speed equipment measurement response • Programming considerations to streamline test flow and processing • An example with respect to EV battery test solutions – low resistance and open-circuit voltage measurements

Topic Description

Topic	Description
<p>Topic 3: Next Gen HSS Testing - PCIe 4/5, DDR5, HDMI 2.1</p>	<p>Key learnings: With each successive PCI Express speed increase, electrical testing challenges compound. As many embark on 32GT/s receiver testing, guidance is needed as engineers tool up for this critical step. This presentation will demystify PHY PCIe Gen4 and Gen5 electrical validation and compliance by introducing tools and methodologies vetted by numerous technology experts within the field.</p> <p>With a significant leap with HDMI 2.1 that enable up to 48Gbps bandwidth supporting higher resolutions up to 10k, faster refresh rates and numerous additional features including the new eARC - enhanced audio return channel, HDMI 2.1 is a next-generation connection. In HDMI 2.1, the maximum link bit rate supported is 12 Gbps on 4 lanes. eARC supports the most advanced audio formats such as object-based audio and enables advanced audio signal control capabilities including device auto-detect. Inevitably, engineers will encounter various issues/challenges while debugging or testing these designs. This presentation shall provide real-world problems faced and the process of uncovering them early on using the test and measurement equipment & solutions. The discussion will also cover the testing issues in terms of measurement & analysis of signal characteristics, probing with fidelity and waveform generation with precision. In addition, this session shall highlight the test solutions you will need to support the HDMI 2.1 specification including the new eARC features.</p>
<p>Topic 4: DataComm (100G/400G NRZ/PAM4 Tx) RT/ET-Scope</p>	<p>Key learnings: Ethernet and OIF/CEI developments in the 50 Gb/s per lane (26 GBd PAM4) and 100 Gb/s per lane (53 GBd PAM4) are deploying early devices. Standards have met reality and some changes are already on the way. We will discuss the challenges, the problems that required changes in these new standards, and the measurement solutions. Focus on TDECQ and similar measurements.</p>
<p>Topic 5: Versatile Signal Generation for Advance Research, Radar or Electronic Warfare and High Speed Digital Design</p>	<p>Key learnings: No matter you are doing quantum communication and computing research, or advanced radar and electronic warfare design, or DAC design, LVDS testing, high-speed serial interfaces testing, or MIMO and I/Q modulator verification, Tektronix have very versatile and scalable low noise high fidelity signal/waveform generators that can meet up even your most demanding signal generation challenges.</p>

ใบตอบรับการเข้าร่วมงาน

“Tektronix Innovation Forum 2019”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

At Salon A, 2 Floor Swissotel Bangkok Ratchada Hotel

- ชื่อ-นามสกุล _____
- ตำแหน่ง/แผนก _____
- บริษัท/หน่วยงาน _____
- โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
- E-mail address _____

วิธีการสำรองที่นั่ง (สำรองที่นั่งด่วน มีจำนวนจำกัด)

1. ส่งใบตอบรับ กลับที่ แฟกซ์หมายเลข 02-645-4589

2. ส่งรายชื่อ พร้อมรายละเอียด มาที่ Email : info@trinergy.co.th

**ลงทะเบียนวันนี้ !
ลุ้นรับของรางวัล!**